

平成 28 年 4 月 11 日

各 位

東京都江東区木場一丁目 5 番 25 号
サムシングホールディングス株式会社
代表取締役社長 前 俊守
(コード番号：1408)

問合せ先：
取締役管理本部長 笠原 篤
(電話番号：03 - 5665 - 0840)
(<http://www.sthd.co.jp/>)

ジオサイン株式会社の資本業務提携に関するお知らせ

当社子会社であるジオサイン株式会社がジャパンホームシールド株式会社と資本業務提携契約を締結しましたので、お知らせいたします。

記

1. 資本業務提携の目的及び経緯

当社の連結子会社であるジオサイン株式会社は、サムシングホールディングス株式会社、兼松日産農林株式会社、及びオリックス株式会社との合弁会社であり、住宅地盤調査及び地盤改良工事の現場における業務支援ツール「G-Webシステム」を開発し、地盤データに第三者として電子認証を行うサービスを展開しています。

このシステムは、地盤調査及び地盤改良工事の実作業を、いつ、どこで、だれが、どの機械で行ったのか、調査・改良工事データと現場写真を記録し、インターネットを通してデータ管理をすることで、データの不正・改ざんを防止し、現場情報をリアルタイムに把握することができます。また、「G-Webシステム」は特許を取得しております。これにより、サムシンググループは地盤調査及び改良工事（当社連結子会社㈱サムシング）から地盤保証（当社連結子会社㈱GIR）までのワンストップサービスを信頼できるデータを基に提供させて頂いております。

昨年の横浜マンションの杭データ改ざん問題以来、大きく損なわれている地盤データに対する信頼性を回復することは急務であり、「G-Webシステム」のニーズは高まっております。業界健全化を早期に実現させるため、4月4日に開催されましたジオサイン株式会社取締役会で第三者割当増資を決議し、ジャパンホームシールド株式会社が全額を引き受けることにより、資本提携をいたしました。

ジャパンホームシールド株式会社は株式会社LIXILグループのグループ企業で、地盤調査・地盤補強工事会社です。サムシンググループのシステムと理念に深く賛同し、当該会社の調査データ及び施工データの品質担保を目的とし、今後当該会社が手掛ける物件に「G-Webシステム」が利用されることとなります。このことは、地盤業界の品質に関するスタンダードを確立することにも資するものです。

本資本業務提携が、「G-Webシステム」の利用拡大による業界の健全化を図り、「見えない世界を見える化する」というサムシンググループの基本理念の実現への推進力となり、地盤調査・改良工事・保証商品の販路拡大を進めていけるものになると考えております。

2. 当社子会社の概要

(1) 名 称	ジオサイン株式会社
(2) 所 在 地	東京都千代田区神田佐久間町 2-7 第 6 東ビル 801
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 成田 芳文
(4) 事 業 内 容	認証システム、地盤調査機及び地盤改良システムのレンタル業、中古地盤調査機及び中古建設機械の買取並びに販売ほか
(5) 資 本 金	57 百万円
(6) 設 立 年 月 日	平成 20 年 1 月 31 日
(7) 大株主及び持株比率	サムシングホールディングス株式会社 61.5% 兼松日産農林株式会社 30.8% オリックス株式会社 7.7%

3. 提携先の概要

(1) 名 称	ジャパンホームシールド株式会社
(2) 所 在 地	東京都墨田区両国 2-10-14 両国シティコア 17F
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 斉藤 武司
(4) 事 業 内 容	地盤調査及び関連業務、地盤補強業務、建物検査業務
(5) 資 本 金	205 百万円
(6) 設 立 年 月 日	平成 2 年 3 月 1 日
(7) 大株主及び持株比率	株式会社 LIXIL グループ 100.0%
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本・人的・取引関係はありません。

4. 第三者割当増資の概要

(1) 発行新株式総数	250 株
(2) 発行価額	1 株につき 150,000 円
(3) 発行総額	37,500,000 円
(4) 増資前持株比率	サムシングホールディングス株式会社 61.5% 兼松日産農林株式会社 30.8% オリックス株式会社 7.7%
(5) 増資後持株比率	サムシングホールディングス株式会社 51.6% 兼松日産農林株式会社 25.8% オリックス株式会社 2.6% ジャパンホームシールド株式会社 20.0%

※発行価額につきましては、独立した第三者算定機関に依頼し、複数の企業価値算定方法によりジオサイン株式会社の株式価値を算定しております。

5. 日程

平成 28 年 4 月 11 日（月） 払込及び割当期日

以上